

設計仕様書

※基本的にはお客様からの設計仕様を優先することとする
 ※お客様より指定のない場合、以下の項目を満足することとする

| | 項目 | PB基準 | 補足 |
|----|-----------------------|--|----------------|
| 1 | 使用CAD | PADS | |
| 2 | 基板仕様 | 材質:FR-4・板厚:1.6mm | 他仕様は別途製造仕様書参照 |
| 3 | 外形 | 550×550mm以下 | |
| 4 | 層数 | お客様指定に準ずる | |
| 5 | 自動挿入機/装着機等の基板位置決め基準穴 | 指定なし | |
| 6 | 基板位置決め基準穴 | 指定なし | |
| 7 | 基板外周及び位置決め基準穴のデッドスペース | 指定なし | |
| 8 | ディスクリート挿入部品 | 手挿入を前提とする | |
| 9 | ディスクリート部品のパッドに関する基準 | メーカー推奨ランドに準ずる | |
| 10 | 挿入ピッチの統一 | 2.54mmを基準とする倍数 | 部品ピッチに準ずる(電解等) |
| 11 | 挿入部品の最小隣接間距離 | 最小部品外形間 0.5mm | |
| 12 | その他特殊部品の自動挿入 | なし(最小部品外形間 0.5mm) | |
| 13 | 表面実装部品のパッドに関する基準 | メーカー推奨ランドに準ずる | |
| 14 | 装着位置決め用認識マーク | 基板内の対角に設置 | |
| 15 | チップ部品間の最小隣接間距離 | 最小部品外形間 0.5mm | |
| 16 | 表面実装IC | 部品外形>ランド 最小部品外形間 0.5 mm 0.5mmピッチからはランド間全面レジスト開口 | |
| 17 | 品質・信頼性の保証 | 製造仕様書に準拠する | 別途製造仕様書参照 |
| 18 | 導体の補強 | スルーホールにはティアドロップあり | |
| 19 | レジスト開口形状 | ランド+0.1mm(全方向) | |
| 20 | 導体間の最小隣接間距離 | 0.125mm | 別途製造仕様書参照 |
| 21 | ミシン目・Vカットに関する基準 | 製造仕様書に準拠する | 別途製造仕様書参照 |
| 22 | 穴径指定基準 | 製造仕様書に準拠する | 別途製造仕様書参照 |
| 23 | 最小パターン幅等の基準 | 製造仕様書に準拠する | 別途製造仕様書参照 |
| 24 | 部品配置に関する基準 | 基板端から部品外形まで1mmは配置不可 | |
| 25 | シルク印刷 | 白色0.2mm幅 | |

